

Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,
Art. Nr. 115-79055

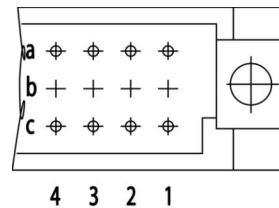
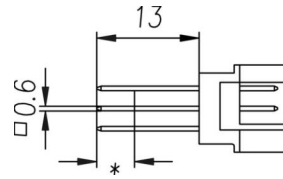
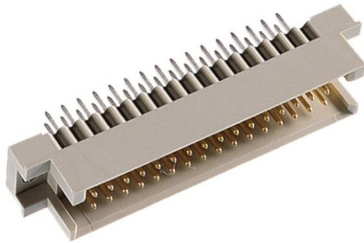


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Rugged

- Anschlusslänge 13 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 32
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe DIN 41612

Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,
Art. Nr. 115-79055



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	32
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	13 mm
Leiterplattenabstand	16.85 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	< 30 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

Elektrisch

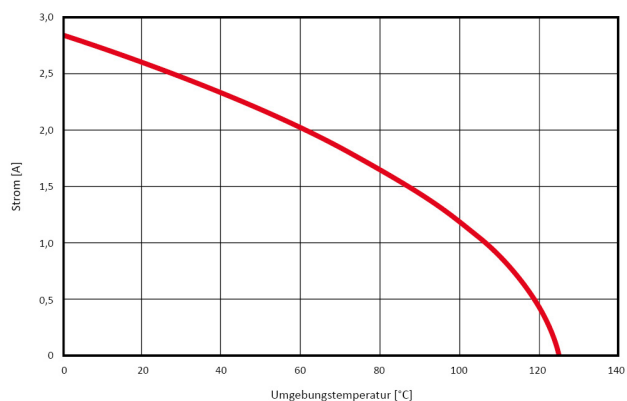
Betriebsstrom	2.6 A
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand	> 10 ⁶ MΩ
Prüfspannung	1000 V

Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

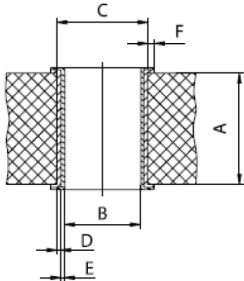
Derating Diagramm

Stromtragfähigkeit DIN R (96-polig)
max. 2.6A bei 20°C



Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

DIN 41612 Messerleiste gerade Bauform R/2,
Art. Nr. 115-79055



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Vor- und nachteilende Kontakte
- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)